

Nacionālā programma „Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijās”

Projekts „Biotehnoloģijas, biomedicīnas, organiskās sintēzes, vides zinātnes un ekoloģijas nozaru zinātniskās infrastruktūras modernizēšana Latvijas Universitātē”

<p>Iekārtas nosaukums</p> <p>Type of equipment</p>	<p>Plānslīpējumu izgatavošana sitēmas komponentes: Struers Diskoplant-TS ģeoloģiskais zāģis Logitech CL40 slīpēšanas un pulēšanas iekārta un WG3 pulēšanas galva ar piederumiem</p> <p>Thin section preparation system: Struers Diskoplant-TS geological saw Logitech CL40 lapping and polishing machine and WG3 polishing head</p>
<p>Fotogrāfija/ Photo</p>	 <p>Logitech WG3 pulēšanas galva uzstādīta uz CL40 slīpēšanas un pulēšanas iekārtas Logitech CL 40 lapping and polishing machine with mounted WG3 polishing head</p>



Struers Diskoplant-TS ģeoloģiskais zāģis / geological saw



Logitech CL 40 slīpēšanas un pulēšanas iekārta sagatavota slīpēšanai
Logitech CL 40 lapping and polishing machine ready for lapping operations

Tehniskie parametri

Struers Diskoplant-TS ģeoloģiskais zāģis:

- Iespēja griezt ar precizitāti līdz 0,2mm un slīpēt ar precizitāti līdz 0,01mm, abrazīvais materiāls ir dimants;
- Paraugu fiksācija: griešanai skavās vai manuāli; griešanai un slīpēšanai – ar vakuuma paraug stikliņu satvērēju;
- Maksimālie vienlaidus apstrādājamā parauga izmēri ir 75x75mm;
- Paralēlās griešanas attālums no parauga vai slaida stiprinājuma vietas sākot līdz 38mm.
- Piemērots darba ar 26x48 līdz 36*58mm lieliem slaidiem

Logitech WG3 pulēšanas galva:

- Automātiska smērvielas padošana pulēšanai;

<p>Technical parameters</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Pulēšanas suspensijas ar dimanta abrazīvu 1µm, 3µm un 6µm izmēru; – Slaidu izmēri: 26x48mm un 36*58mm <p>Struers Diskoplant-TS geological saw:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Diamond abrasive disk saw with cutting precision 0,2mm and lapping precision u to 0,01mm; – Vacuum chuck-face fixation of mounted specimens; – Maximal sample size 75*75mm; – Distance of parallel cutting: up to 38mm; – Suited for 26x48 to 36*58mm large slides. <p>Logitech CL40 lapping and polishing system with WG3 polishing head:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Automated lubrication; – Polishing suspensions with 1µm, 3µm and 6µm diamond grains – Slid size: 26x48mm and 36*58mm
<p>Iekārtas pielietojums</p> <p>Application of equipment</p>	<p>Iekārtu komplekts tiek pielietots iežu un nogulumu plānslīpējumu izgatavošanai.</p> <p>The equipment is used for preparation of rock thin sections.</p>
<p>Atbildīgais par iekārtu (vārds, uzvārds, struktūrvienība, adrese, telefons, fakss, e-pasts)</p> <p>Responsible for equipment (name, surname, division, address, phone, fax, e-mail)</p>	<p>Andis Kalvāns LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Ģeoloģijas nodaļa Iežu pētījumu laboratorija Alberta iela 10, Rīga telefons: 7331766, fakss: 7332704 e-pasts: andis.kalvans@lu.lv</p> <p>Andis Kalvans University of Latvia, Faculty of Geography and Earths Sciences, Department of Geology Laboratory of Rocks phone: 7331766, fax: 7332704 e-mail: andis.kalvans@lu.lv</p>